Influence of nitrogen amount on structural, morphological properties of WN thin films

S. Askari^{1*}, Z. Ebrahiminezhad¹

Submit Date: 2018.10.15 Revise Date: 2018.09.15 Accept Date: 2019.02.16

Abstract

Tungsten nitride (W_XN) thin films with crystalline structure were deposited by reactive Chemical Vapor Deposition (CVD) technique at different mixtures of N_2 and Ar mixture gases. Experimental data demonstrated that different N_2 concentrations in gas mixture, strongly affect microstructure, phase formation, grain size and texture morphology of the W_XN films. According to XRD spectra, growth of tungsten nitride films promoted hexagonal WN phase for lower N_2 concentration in gas mixture ($N_2=10\%$, $N_2=30\%$ and $N_2=50\%$) and layers have non- homogenous morphology with rough surface. At higher N_2 concentrations ($N_2=80\%$ and $N_2=100\%$) a phase transition was happened and two hexagonal WN and cubic W_2N crystalline phases were observed. It seems that nitrogen concentration has strong effect on preferred growth orientation. The layers have smooth surfaces with low roughness. SEM micrographs for deposited films at lower nitrogen concentrations in gas mixture, indicated a definite dense columnar nanostructure and non-columnar at higher nitrogen amount.

Keywords: Thin film, Tungsten nitride , Crystslline phase, surface morphology

¹ Department of Islamic of Azad University

^{*} Corresponding author: sima198124@yahoo.com

https://jap.alzahra.ac.ir/

بررسی اثر مقدار نیتروژن بر خصوصیات ساختاری و مورفولوژی سطح لایههای ناز ک نیترید تنگستن^ا

سمیه عسگری^{**}، ژاله ابراهیمینژاد^۳

تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

چکیدہ

لایه های نیترید تنگستن با ساختاری بلوری به روش تبخیر شیمایی و در غلظت های مختلفی از گاز نیتروژن در ترکیب گازی آرگون و نیتروژن تولید شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که غلظت نیتروژن در گاز ترکیبی تأثیر بسزایی در ساختار، فازهای تشکیل شده، مورفولوژی سطح لایه ها و حتی اندازهٔ دانه ها دارد. پراش اشعهٔ ایکس، ساختار بلوری هگزاگونال NW را در نمونه های با غلظت کم نیتروژن (۱۰٪=۸۵ ٪۳۰ = ۲۵ و ۵۰٪=۸۷) نشان می دهد و لایه ها دارای مورفولوژی غیریکنواخت با سطوحی زبر هستند. در غلظت های بیشتر نیتروژن (۷۰۰ = ۸۷) تغییر فاز رخ می دهد و دو ساختار بلوری مربعی NgW و NW هگزاگونال مشاهده می شود. به نظر می رسد که غلظت نیتروژن در جهت رشد ترجیحی فازهای بلوری نیز تأثیر بسزایی دارد. لایه ها دارای سطوحی

['] شناسه ديجيتال (DOI): 10.22051/jap.2019.17614.1083

^۲ گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه .دانشگاه ازاد تهران غرب (نویسنده مسئول)؛ sima198124@yahoo.com ^۳ فیزیک – دانشکده علوم پایه – دانشگاه ازاد تهران غرب

صاف و زبری کـم میباشند. تصاویر میکروسکوپ پراش الکترونـی ساختار ستونی برای غلظـتهـای کـم نیتـروژن و سـاختار چگـال و غیـر سـتونی را بـرای غلظتهای زیاد نیتروژن نشان میدهد.

واژدهای کلیدی: لایهٔ ناز ک، نیترید تنگستن، فاز بلوری، مورفولوژی سطح.

۱. مقدمه

نیترید تنگستن متعلق به گروه فلزات واسطه است، که دارای خواص منحصربه فردی از قبیل سختی شدید [۱]، رسانایی زیاد [۲]، نقطهٔ ذوب بالا، پایداری شیمیایی فوق العاده [۳]، رسانایی حرارتی خوب [۴]، پایداری حرارتی زیاد [۵] و گاف انرژی نسبتاً کوچک (۲٫۲ الکترون ولت) [۶] است. امروزه این ماده به دلیل کاربردهای خاص آن در لایهٔ مانع عبور در وسایل میکروالکترونیکی [۷]، اتصالات شاتکی در گالیم زرنیخ [۸]، کاتالیست کاتدی در سلولهای سوختی [۹]، پوشش های اپتیکی در صنعت ساخت آیینه های اشعهٔ ایکس [۱۰]، دریچه های الکترود در ترانزیستورهای اثر میدانی نیمه رسانا اکسید فلزی [۱۱]، حسگرها [۱۲]، پوشش سخت برای محافظت ابزارهای برش [۱۳] و فوتو کاتالیست در تجزیهٔ آب در برابر نور خورشید [۱۴] بسیار مطالعه شده است.

بهطور کلی روش های مختلفی برای لایهنشانی لایهٔ نازک نیترید تنگستن وجود دارد که می توان به کندوپاش واکنشی مگنترونی [۱۵] لایهنشانی به روش پالس لیزر [۱۶]، نیتریده کردن لایه های تنگستن [۱۷]، لایهنشانی به روش پر تویونی [۱۸]، قوس کاتدیک [۱۹]، پلاسمای کانونی [۲۰]، لایهنشانی لایه ای اتمی [۲۱]، لایهنشانی به روش تبخیر شیمیایی [۲۲]، تبخیر شیمیایی فلزات آلی [۲۳]، کاشت یونی [۲۴]، تبخیر شیمیایی پلاسما [۲۵] اشاره کرد.

فازهای مختلفی برای نیترید تنگستن وجود دارد از قبیل W₂N با ساختار مربعی، WN با ساختار هگزاگونال و WN2 با ساختار رومبوهدرال. از آنجا که WN2 بسیار ناپایدار است، ترکیب شناخته ای با این ترکیب استوکیومتری وجود ندارد [۲۶]. ساختار مربعی W₂N، پایدارترین فاز محسوب می شود و در اکثر مطالعات مربوط به رشد لایهٔ نازک نیترید تنگستن مشاهده می شود [۲۷].

ساختار نیترید تنگستن متشکل از اتمهای تنگستن در ساختار مکعبی چهره پر (fcc) است. وقتی همهٔ حفرههای اکتاهدرال آن از اتمهای نیتروژن پر شود، ساختار هگزاگونال WN شکل می گیرد و اگر نصف حفرهها از نیتروژن پر شود، ساختار W₂N پدید می آید [۲۸]. اصولاً لایهنشانی نیترید تنگستن با معضل همراه است، زیرا ورود نیتروژن به ساختار تنگستن در فشار اتمسفر به لحاظ ترمودینامیکی نامطلوب است. هدف اصلی این مقاله ورود مقادیر مختلفی از نیتروژن درون

تنگستن است تا بهترین شرایط رشد لایه از لحاظ بلوری شدن و مسطح بودن لایـه حاصـل شـود. اندازه و شکل ذرات تأثیر بسیار زیادی در نوع عملکرد و وسعت کارایی آنها دارد. بنـابراین، تـلاش برای تولید نانوبلورها، بهینهسازی، کنترل شکل، اندازه و توزیع یکنواخت ذرات انجام گرفته است.

۲. روش کار

در ابتدا ویفرهای تکبلوری سیلیکون (۱۰۰) Si نوع P که به عنوان زیر لایه استفاده شده اند، ۱۵ دقیقه با استفاده از دستگاه آلتر اسونیک به ترتیب در استون و اتانل تمیز شده اند. برای جلو گیری از تأثیر مقاومت زیر لایه سیلیکون در مقاومت لایهٔ ناز ک نیترید تنگستن، ویفرها به مدت نیم ساعت در دمای ۸۰۰ درجهٔ سلسیوس در مجاورت گاز O2 در کوره حرارت دهی شده اند تا لایهٔ ناز ک اکسید سیلیکون (حدود ۱۰ نانومتر) تشکیل شود. برای به دست آوردن بهترین شرایط رشد لایهٔ نیترید تنگستن با استفاده از روش تبخیر شیمیایی، غلظت گاز نیتروژن در گاز مخلوط گازی نیتروژن+آر گون، از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد تغییر داده شد. ملکول های گاز نیتروژن بر اثر مجاورت با فیلامان داغ تنگستن که دمای آن حدود (۱۰۰۰ ـ ۱۸۵۰ درجهٔ سلسیوس) است به اتم های نیتروژن تجزیه می شود و رسوبات تنگستن (ذرات ریزی که به دلیل دمای بالای فیلامان از آن جدا می شوند) طی واکنشی با اتم های نیتروژن بر روی زیر لایهٔ اکسید سیلیکون رسوب می کنند. این روش به دلیل سهولت استفاده شده است.

در شکل ۱، طرحوارهای از دستگاه لایهنشانی نشان داده شده است.



شکل ا طرحوارهٔ دستگاه لایهنشانی.

از یک منبع تغذیهٔ DC برای تولید جریان الکتریکی و ولتاژ مورد نیاز برای حرارت دادن فیلامان تنگستن استفاده شده است. دمای زیرلایه توسط یک ترمو کوپل که با پایهٔ نگهدارندهٔ زیرلایه در تماس است تا حدود ۶۰۰ درجه سلسیوس بالا برده می شود.

گاز درون محفظهٔ خلاً در ابتدا توسط پمپ مکانیکی تخلیه شد و وقتی فشار پایه در محفظه حدود ^{۵-}۲X۱۰ تور رسید، مخلوط گازی با نرخ ثابت ۵۰ SCCM توسط فلومتر به داخل محفظهٔ خلاً هدایت شد تا فشار کل به مقدار ۲-۲X۱۰ تور برسد. خلاصهای از پارامترهای رشد برای لایه های نیترید تنگستن در جدول ۱ داده شده است.

پس از ۵ دقیقه لایه نشانی با مخلوطهای گازی متفاوت، لایههای نازک نیترید تنگستن با ساختارهای بلوری متفاوت لایه نشانی شد.

رای بحث راجع به ساختار لایههای نازک ایجادشده، از دستگاه پراش اشعهٔ X که با منبع α Cu K در طول موج ۱۵۴۱۸ • = λنانومتر استفاده شد. بـرای بررسـی اطلاعـات توپـو گرافی لایـههـای نازک از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) استفاده شد. بـه منظـور تحلیـل بیشـتر از مورفولـوژی سطح و یکنواختی و ضخامت لایههـا، از میکروسکوپ پـراش الکترونـی (SEM) استفاده شـده و برای اندازه گیری مقاومت الکتریکی آن از تکنیک پروب چهارنقطهای استفاده شد.

فشار کاری	2×10^{-2} torr	
فشار پايه	2×10^{-5} torr	
دماي زيرلايه	۶۰۰ (درجه سلسيوس)	
زمان لايەنشانى	۳۰۰ (ثانیه)	
ولتاژ اعمالي به فيلامان	۱۱ (ولت)	
جريان اعمالي به فيلامان	۵ (آمپر)	
فاصلة فيلامان تا زيرلايه	۲ (سانتیمتر)	

جدول 1 پارامترها و شرایط لایهنشانی.

۳. تحليل و بررسي نتايج

أ. XRD

الگوی پراش لایههای نازک نیترید تنگستن نشاندهشده در غلظتهای مختلف نیتروژن در مخلوط گازی در شکل ۲ نشان داده شده است.

با استفاده از این آنالیز می توان اطلاعاتی در خصوص ساختار و جنس ماده و تعیین مقادیر عناصر بهدست آورد. در اینجا تشکیل فازهای بلوری و تغییر فاز در لایه های مختلف، تابعی از غلظت گاز نیتروژن در محفظهٔ گازی است. در نمونهٔ ۱۰٪=یN لایهٔ نیترید تنگستن تک کریستال ایجاد شده است. یک قله با شدت کم در حدود زاویهٔ ۳۲،۷۵ درجه با ثابت شبکهٔ ۲،۸۹=۵ نانومتر

ظاهر شده است، که می توان آن را به فاز هگزاگونال تنگستن نیترید (۲۵-۱۲۵۶ کارت استاندارد) نسبت داد. در نمونهٔ ٪۲۰۹=N₂، لایه ای با میزان بلوری بیشتر نسبت به نمونهٔ اول دیده شد، که سه قله در زوایای ۳۲،۷۵ (۴۸،۰۳ و ۲۵،۲۶ درجه منطبق بر صفحات (۱۱۱) و (۰۰۱) و (۲۰۰) منونیترید تنگستن در فاز هگزاگونال دارد.

ظهور قلهٔ (۰۰۱) WN با شدت زیاد جهت رشد ترجیحی بلور در این شرایط است. در واقع، تحرک اتمهای اضافه شده به اندازهٔ کافی شدید است که بتوانند پیوندهای بلوری دلخواه را با صفحاتی با کمترین انرژی ایجاد کنند. بر طبق نتایج به دست آمده، فاز WN، فاز ترجیحی رشد بلوری در غلظتهای کم نیتروژن در مخلوط گازی است. هیچ یک از فازهای W و W₂N در غلظتهای کم نیتروژن در مخلوط گازی مشاهده نشده است.



شکل ۲ الگوی پراش اشعهٔ X نمونههای نیترید تنگستن در غلظتهای مختلف گاز نیتروژن.

وقتی غلظت نیتروژن در مخلوط گازی افزایش مییابد، تغییر فاز در ساختار بلوری مشاهده می شود (در نمونهٔ ٪۵۰=N2). در این نمونه، ترکیبی از فازهای مونونیترید هگزاگونال تنگستن و دینیترید تنگستن با ساختاری مربعی و تنگستن (۵۰۹-۸۰۶ کارت استاندارد) میزان بلوری شدن زیاد مشاهده می شود. فاز WN دارای دو قلهٔ پراش در زوایای ۳۵،۴۷ و ۸۸٬۹۸ درجه منطبق بر صفحات بلوری (۱۰۰) و (۰۰۱) است. فاز W2N (۲۵-۱۲۷۵ کارت استاندارد) نیز دارای دو قلهٔ اصلی در زوایای ۲۵٬۲۵ و ۴۳٬۹۴ درجه منطبق بر صفحات (۱۱۱) و (۲۰۰) است. علاوه بر آن، سه قلهٔ دیگر در زوایای ۴۰٬۱۶ ۵۸٬۵۷ و ۷۳٬۲۹ درجه مشاهد شده است، که متعلق به فاز (۳–۵) است.

قلهٔ (۱۱۱) WN در نمونهٔ ۵۰٪=N₂ کاملا ناپدید و یک قلهٔ جدید WN با شدت ضعیف تر ایجاد شده است. در نمونهٔ ۸۰٪=N₂ چندین قله در زوایای ۳۸،۱۹ ، ۳۳،۹۴ ، ۸۷،۴۷ ، ۶۴،۵۷ ، ۷۷،۹۷ و ۸۲،۲۲ درجه مشاهده شده است، که به تر تیب به صفحات بلوری (۱۱۱) W₂N، (۲۰۰) (۷۰۷، ۱۰۰) WN، (۲۰۱) (۷۱۰) W₂N و ۲۲۱) W₂N و ۲۲۲ تعلق دارد. دو قلهٔ (۳۱۱) W₂N و (۲۰۰) W در شرایط لایهنشانی قبلی مشاهده نشده است.

در نمونهٔ ۱۰۰٪=N₂ هر دو فاز W₂N و WN مشاهده می شود. این نمونـه دارای بیشـترین میـزان بلوری شدن است. بهنظر میرسد که تمامی قلهها به سمت زوایای کوچکتر جابهجا شدهاند.

با افزایش غلظت نیتروژن در مخلوط گازی، جایگاه مکانی قلهٔ (۰۰۱) WN در نمونه های ۳۰٪=N2 و ۵۰٪=N2 بدون تغییر مانده ولی شدت آن کم شده است، که احتمالاً به دلیل جهت گیری ترجیحی دانه ها در ساختار است. جایگاه این قله در نمونهٔ ۸۰٪=N2 کمی به سمت زوایای کوچکتر جابه جا شده است.

	• • •		-	
نمونهها	زاويهٔ پراش (20)	اندیس میلر (hkl)	فاصلة صفحات (d)	ساختار فازى
100/	23.60	001	3.81	WO ₃
10%	32.90	111	2.27	WN
	23.60	001	3.78	WO ₃
200/	32.90	111	2.72	WN
30%	47.99	001	1.89	WN
	75.35	200	1.26	WN
	23.60	001	3.76	WO ₃
	25.94	006	3.43	W_2N
	35.65	100	2.51	WN
	40.19	110	2.24	W
50%	43.94	200	2.05	W_2N
	47.99	001	1.85	WN
	72.75	211	1.52	W
	23.60	001	3.78	WO ₃
	38.02	111	2.36	W_2N
	43.94	200	2.04	W_2N
	47.99	001	1.89	WN
80%	58.99	200	1.56	W
8070	64.37	110	1.45	WN
	77.95	311	1.22	W_2N
	81.99	222	1.12	W_2N
	24.13	001	5.13	WO ₃
	26.19	006	3.40	W_2N
	38.21	111	2.35	W_2N
	40.34	110	2.23	W
100%	44.85	200	2.01	W_2N
	48.49	001	1.87	WN
	78.43	311	1.21	W_2N

جدول ۲ خلاصهای از اطلاعات الگوی پراش.

الگوی پراش اشعهٔ X نشان میدهد که با افزایش غلظت نیتروژن در مخلوط گازی، نرخ بلوری شدن بهبود یافته و تغییر فاز WN به W₂N رخ میدهد (با افزایش نیتروژن، لایـه تمایـل بیشـتری بـه بلوری شدن در فاز W₂N دارد).

در تمامی نمونهها در زوایای ۲۳،۲۲ و ۵۳،۳۲ درجه، دو قلهٔ WO3 ۲۰۰۳ کارت استاندارد) منطبق بر صفحات بلوری (۰۰۱) و (۲۰۴) مشاهده می شود. پیدایش فاز WO3 در تمام لایهها بهدلیل واکنش سریع تر اکسیژن با تنگستن در مقایسه با نیتروژن است. گرمای تشکیل WO3 حدود ۲۰۰ کیلوکالری بر مول است [۳۱].

٤. نتايج AFM

با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی، اطلاعات توپو گرافی و زبری سطح برای در ک کیفیت لایههای ناز ک نیترید تنگستن استخراج شده است. نفوذ سطحی، کلوخه شدن دانهها و نرخ رشد لایههای ناز ک از جمله پارامترهای مهم در تغییرات میکروساختار است [۳۳]. بر طبق تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی، غلظت نیتروژن در مخلوط گازی تأثیر زیادی در زبری سطح لایههای ناز ک داشته است. تصاویر دوبعدی و سهبعدی لایهها در شکل ۳ آمده است. بزر گترین دانهها د نمونه ۱۰٪=N دیده می شود. این لایه دارای بیشترین زبری سطح در مقایسه با سایر لایههاست. در بیشتر کاهش می یابد. با افزایش غلظت نیتروژن به ۱۰٪ و ۱۰۰٪ در مخلوطهای گازی، تعداد زیادی خوشهٔ متشکل از دانههای کوچکتر از نمونهٔ ۱۰٪=N است. در مخلوطهای گازی، تعداد تقریباً همگن و در نمونهٔ ۱۰۰٪ کاملاً همگن است. بر طبق توپو گرافی سطح، نمونههای ۲۰٪ و جگالی اندک این لایهها ست.

بر طبق نتایج میکروسکوپ نیروی اتمی، لایههایی که در غلظتهای کمنیتروژن در مخلوط گازی نشانده شدهاند، دارای دانههای نسبتاً بزرگ و زبری شدید سطح هستند. این پدیده احتمالاً به دلیل کلوخه شدن بلور کهای نیترید تنگستن و تشکیل جزیرههایی بر روی سطح لایههای نازک شده است [۳۳]. به عبارت دیگر، بهدلیل آهنگ لایهنشانی کمتر در غلظت کم نیتروژن در مخلوط گازی، ذرات رسوب کرده وقت بیشتری دارند تا به سطح مهاجرت کنند و در نتیجه اندازهٔ دانهها بزرگتر میشود. اندازهٔ دانهها در نمونهٔ ۸۰٪ از اندازهٔ دانهها در نمونهٔ ٪۱۰۰ کوچکتر است و حتی کوچکتر از دانههای سایر لایههای نازک است.

به نظر می رسد که اندازهٔ دانه ها به طور خطی با افزایش غلظت نیتروژن در مخلوط گازی کوچکتر شده است. این پدیده یا به دلیل تغییرات در سازو کار واکنش به علت شکل گیری فاز غالب W₂N (به جای WN) یا ناشی از آهنگ رشد بزرگتر در غلظت های بیشتر نیتروژن در مخلوط گازی است، که نفوذ و منظم شدن مجدد ذرات جذب شده را بر روی سطح زیرلایه محدود می کنند و در نتیجه لایه هایی با دانه های کوچک تر تشکیل می شود [۳۴].

به عبارت دیگر، رسوبات رسیده به سطح فرصت کافی برای رشد و تبدیل شدن بـه دانـههـای بزرگ تر ندارند. در نتیجه، نفوذ سطحی فاکتور اصلی کنترل این پدیده است. کاهش اندازهٔ دانههـا به یک میکروساختار دانهای خوب و کاهش زبری سطح میانجامد.



شکل ۳ مورفولوژی لایهها با غلظتهای متفاوت نیتروژن در مخلوط گازی (a) N₂= 10% (c) N₂= 10%, (d) N₂= 80%, (c) N₂=50%, (b) N₂= 30%

زبری سطح نمونه به عنوان تابعی از غلظت نیتروژن در مخلوط گازی در شکل ۴ نشان داده شده است. وقتی غلظت نیتروژن در مخلوط گازی افزایش مییابد، زبری سطح نمونهها کم می شود و نمونهها دارای سطوحی صافتر و زبری کمترند. بنابراین غلظت نیتروژن در مخلوط گازی نقش اساسی در کیفیت لایهها دارد.



شکل ٤ تغییرات زبری سطوح با تغییر غلظت نیتروژن در مخلوط گازی.

٥. نتايج SEM

اثر غلظت نیتروژن در مخلوط گازی در مورفولوژی سطح در شکل ۵ نشان داده شده است. در نمونههای ٪۱۰=N، ستونهای تقریباً میلهای شکل (نانومیله) که به صورت موازی در کنار هم قرار دارند، مشاهده می شود که پهنای ستونهای آن حدود ۱۰۹ نانومتر است. در نمونهٔ ٪۳۰=Nی ستونهای منظم میلهای شکل موازی با چگالی بیشتر از نمونهٔ قبلی مشاهده می شود. در نمونهٔ ۵.۷۵=N، ساختار ستونی با اندازهٔ ستونهای بزرگ تر با پهنای ۱۳۵-۱۴۴ نانومتر بر روی سطح لایه مشاهده می شود، که نشاندهندهٔ بهترین شرایط رشد ستونی در مقایسه با سایر نمونههاست. در ۱۰مونههای ۸۰۰/=N و ۱۰۰٪=N، یک سطح پیوسته و بدون حفره با مرزهایی واضح دیده می شود. ۲۰٪ یورات پهنای ستونها با غلظت نیتروژن در مخلوط گازی در شکل ۶ آمده است. در نمونههای ۱۰۰٪=N و ۳۰۰٪=Nی می ایندازه می می بر روی سطح نمونهها مشاهده می شود و پهنای میانگین ستونها با افزایش غلظت نیتروژن افزایش یافته است.

۵۶ / بررسی اثر مقدار نیتروژن بر خصوصیات ساختاری و مورفولوژی سطح لایههای نازک نیترید تنگستن



شکل 0 تصاویر SEM نمونه ها با غلظتهای متفاوت نیتروژن در مخلوط گازی MD2= 10%,(b) N2= 30%, (c) N2= 50% (e) N2= 100%, (d) N2= 80%



شکل ٦ نمودار پهنای ستونها با غلظت نیتروژن در مخلوط گازی.

۲. نتیجه گیری پراش اشعهٔ ایکس نشان میدهد که بر طبق غلظت نیتروژن در مخلوط گازی، فازهای بلوری متفاوتی شکل گرفته است. برای ۳۰٪≥N فاز WN مشاهده شده است. در نمونهٔ ۳۰٪<N₂ تغییر فاز از هگزاگونال منونیترید به دینیترید تنگستن با ساختار مربعی اتفاق میافتد. گرمای تشکیل رابطهٔ

مستقیمی با ساختار دارد. گرمای تشکیل محاسبه شده برای تشکیل W₂N و WN به ترتیب برابر است. با 22– و 15– کیلوژول بر مول. W₂N گرماده تر است و به همین دلیل از WN پایدار تر است. این لایه ها در غلظت های کم نیتروژن در مخلوط گازی دارای مورفولوژی غیریکنواخت و سطوحی زبرند. تصاویر میکروسکوپ پراش الکترونی در غلظت های کم نیتروژن در مخلوط گازی به وضوح ساختار ستونی را برای لایه ها نشان می دهد و سطوحی با مرزدانه های واضح و نزدیک به هم برای غلظت های زیاد نیتروژن در مخلوط گازی نشان می دهد.

مراجع

[1] Constable C. P., Yarwood J., Munz W.D. "Raman Microscopic Studies of PVD Hard Coatings". *Surf. Coat. Technol.*, 1999; 116-119(2-3): 155.

[2] Becker S.J., Suh S., Wang Sh., Gordon R.G. "Highly Conformal Thin Films of Tungsten Nitride Prepared by Atomic Layer Deposition from a Novel Precursor". *Chem. Mater.*, 2003; 15(15):2969.

[3] Marco J.F., Gancedo J.R., Auger M.A., Sanchez O., Albella J.M. "Chemical stability of TiN, TiAlN and AlN layers in aggressive SO2 environments". *Surf Interface Anal.*, 2005; 37(12): 1082.

[4] Glaser A., Surnev S., Netzer F.P., Fateh N., Fontalvo G.A., Mitterer C. "Oxidation of vanadium nitride and titanium nitride coatings". *Surf. Sci.*, 2007; 601(4): 1153.

[5] Huang C.F., Tsui B.Y., Lu C.H. "Thermal Stability and Electrical Characteristics of Tungsten Nitride Gates in Metal–Oxide–Semiconductor Devices". *Jpn. J. Appl. Phys.*, 2008; 47(2):872.

[6] Chakrapani V., Thangala J., Sunkara M.K. "WO3 and W2N nanowire arrays for photoelectrochemical hydrogen production". *Hydrogen energy*, 2009; 34(22): 9050.

[7] Wang Z., Liu Z., Yang Z., Shingubara S. "Characterization of sputtered tungsten nitride film and its application to Cu electroless plating". *Microelectronic Engineering*. 2008; 85:395.

[8] Lee C.W., Kim Y.T. "High temperature thermal stability of plasma-deposited tungsten nitride Schottky contacts to GaAs". *Solid State Electronics*, 1995; 38(3): 679.

[9] Lee C.W., Kim Y.T., Min S.K. "Characteristics of plasma enhanced chemical vapor deposited tungsten nitride thin films". *Appl. Phys Lett.*, 1993; 62(25): 3312.

[10] Shen Y.G., Mai Y.W., McBride W.E., Zhang Q.C., McKenzie D.R. "Characteristics in sputtered tungsten nitride films". *Thin Solid Films*. 2000; 37(1-2): 257.

[11] Moriwaki M., Yamada T., Harada Y., Fujii S., Fujii S., Yamanaka M., Shibata J., Mori Y. "Improved metal gate Process by Simultaneous Gate-Oxide Nitridation during W/WNx Gate Formation". *Jpn. J. Appl. Phys.*, 2000; 39 (4): 2177.

[12] Ko A., Han S.B., Lee Y.W., Park K.W. "Template-free synthesis and characterization of mesoporous tungsten nitride nanoplates. Phys". *Chem. Chem. Phys.*, 2011;13(28): 12705.

[13] Levy F., Hones P., Schmid P.E., Sanjines R., Diserns M., Wiemer C. "Electronic states and mechanical properties in transition metal nitrides". *Surf. Coat. Technol.*, 1999; 120/121; 284.

[14] Chang K.M., Yeh T.H., Deng I.C., Shih C.W. "Amorphouslike chemical vapor deposited tungsten diffusion barrier for copper metallization and effects of nitrogen addition". *J. Appl. Phys.*, 1997; 82(3): 1469.

[15] Jiang P.C., Lai Y.S., Chen J.S. "Dependence of crystal structure and work function of WNx films on the nitrogen content". *Appl. Phys. Lett.*, 2006; 89(12): 122107.

[16] Bereznai M., Toth Z., Caricato A.P., Fernández M., Luches A., Majni G., Mengucci P., Nagy P.M. "Reactive pulsed laser deposition of thin molybdenum- and tungsten-nitride films". *Thin Solid Films*. 2005; 473(1): 16.

[17] Chang K.M., Yeh T.H., Deng I.C. "Nitridation of fine grain chemical vapor deposited tungsten film as diffusion barrier for aluminum metallization". *Appl. Phys.*, 1997; 81(8): 3670.

[18] Eizenberg M., Meyer F., Benhocine A., Bouchier D. "Reactive-ion-beamsputtered WNx films on silicon: Growth mode and electrical properties". *J. Appl. Phys.*, 1994; 75(8): 3900.

[19] Yamamoto T., Kawate M., Hasegawa H., Suzuki T. "Effects of Nitrogen Concentration on Microstructures of WNX Films Synthesized by Cathodic Arc Method". *Surf. Coat. Technol.*, 2005; 193(1-3): 372.

[20] Etaii G.R., Hosseinnejad M.T., Ghoranneviss M., Habibi M., Shirazi M. "Deposition of tungsten nitride on stainless steel substrates using plasma focus device". *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B.* 2011; 269(10): 1058.

[21] Bystrova S., Aarnink A.A.I., Holleman J., Wolters R. "Atomic Layer Deposition of W1.5N Barrier Films for Cu Metallization". *J. Electrochem. Soc.*, 2005; 152(7): 522.

[22] Lu J.P., Hsu Y., Luttmer J.D., Magel L., Tsai H.L. "A New Process for Depositing Tungsten Nitride Thin Films". *J. Electrochem. Soc.*, 1998; 145(2): 21.

[23] Tsai M.H., Chiu H.T., Chuang S.H. "Metalorganic chemical vapor deposition of tungsten nitride for advanced metallization". *Appl. Phys. Lett.*, 1996; 68(10):1412.

[24] Feugeas JN, Llonch EC, de Gonzalez CO, Galambos G. Nitrogen implantation of AISI 304 stainless steel with a coaxial plasma gun. J. Appl. Phys., 1988; 64(5): 2648.

[25] Meunier C., Monteil C., Savall C., Palmino F., Weber J., Berjoan R., Durand J. "RBS-ERDA, XPS and XRD characterizations of PECVD tungsten nitride films". *Appl. Surf. Sci.*, 1998; 125(3-4): 313.

[26] Shen Y.G., Mai Y.W. "Structural studies of amorphous and crystallized tungsten nitride thin films by EFED, XRD and TEM". *Applied Surface Science*, 2000; 167(1-2): 59.

[27] Becker J.S., Suh S., Wang S., Gordon R.G. "Highly Conformal Thin Films of Tungsten Nitride Prepared by Atomic Layer Deposition from a Novel Precursor". *Chem. Mater.*, 2003; 15(15):2969.

[28] Nakajima T., Watanabe K., Watanabe N. "Preparation of Tungsten Nitride Film by CVD Method Using WF6". *J. Electrochem. Soc.*, 1987; 134(12):3175.

[29] Jiang P.C., Yen C.K., Chen J.S. "Influence of thickness on the material characteristics of reactively sputtered W_2N layer and electrical properties of W/W₂N/SiO₂/Si capacitors". *J. Alloys and Compounds*, 2008; 463(1-2): 522.

[30] Dirks A.G., Wolters R.A.M., De Veirman A.E.M. "Columnar microstructures in magnetron-sputtered refractory metal thin films of tungsten, molybdenum and W-Ti-(N)". *Thin Solid Films*, 1992; 208(2):181.

[31] Klaus J.W., Ferro S.J., George S.M. "Atomic Layer Deposition of Tungsten Nitride Films Using Sequential Surface Reactions". *J. Electrochemical Society*, 2000; 147(3):1175.

[32] Uekubo M., Oku T., Nii K., Murakami M., Takahiro K., Yamaguchi S., Nakano T., Ohta T. "WNx diffusion barriers between Si and Cu". *Thin Solid Films*,1996; 286(1-2):170.

[33] Jiang P.C., Lai Y.S., Chen J.S. "Dependence of crystal structure and work function of WNx films on the nitrogen content", *Appl. Phys. Lett.* 89(12):122107.

[34] Ou K.L., Wu W.F., Chou C.P., Chiou S.Y., Wu C.C. "Improved TaN Barrier Layer Against Cu Diffusion by Formation of an Amorphous Layer Using Plasma Treatment". *J. Vac. Sci. Technol B.*, 2002; 20(5): 2154.